

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2019-012

北京君正集成电路股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，仍为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 201,209,956 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京君正	股票代码	300223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张敏	白洁	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层	
传真	010-56345001	010-56345001	
电话	010-56345005	010-56345005	
电子信箱	investors@ingenic.com	investors@ingenic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为集成电路设计企业，拥有全球领先的 32 位嵌入式 CPU 技术和低功耗技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等产品及整体解决方案的研发和销售。公司拥有较强的自主创新能力，多年来在自主创新 CPU 技术、视频编解码技术、图像和声音信号处理技术、SoC 芯片技术、嵌入式神经网络处理技术、智能视频分析算法技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。目前，公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，基于自主创新的 XBurst CPU 和视频编解码等核心技术，

公司推出了一系列具有高性价比的微处理器芯片产品和智能视频芯片产品，各类别的芯片产品分别面向不同的市场领域，微处理器芯片主要面向智能家居、智能家电、二维码、智能穿戴、智能门锁等物联网市场和生物识别等市场，智能视频芯片主要面向商用和家用消费类智能摄像头及泛视频类市场。

公司专注于芯片的设计研发，产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品设计方案的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turnkey”的整体解决方案。

报告期内，公司紧跟市场需求变化，及时把握新的市场机会，加快各领域中的关键技术研发和新产品开发，充分发挥公司产品在性能、功耗和性价比等各方面的竞争优势，不断加强市场推广力度。公司在主要产品应用领域的销售均实现了同比增长，尤其在物联网领域，公司市场销售增长迅速，使得公司总体营业收入及净利润较去年同期显著增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	259,670,111.20	184,467,019.32	40.77%	111,685,840.09
归属于上市公司股东的净利润	13,515,446.01	6,501,097.82	107.89%	7,052,089.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,762,201.76	-18,444,448.44	-12.57%	-23,864,218.01
经营活动产生的现金流量净额	36,370,741.66	-30,694,037.69	218.49%	-65,723,330.53
基本每股收益（元/股）	0.0674	0.0325	107.38%	0.0353
稀释每股收益（元/股）	0.0674	0.0324	108.02%	0.0353
加权平均净资产收益率	1.19%	0.59%	0.60%	0.65%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,197,980,221.27	1,156,759,952.66	3.56%	1,134,828,507.64
归属于上市公司股东的净资产	1,141,926,913.09	1,124,827,625.96	1.52%	1,097,593,676.71

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,190,612.47	63,434,704.93	57,846,029.62	99,198,764.18
归属于上市公司股东的净利润	2,968,093.35	8,893,336.48	8,932,312.53	-7,278,296.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,562,122.44	-2,064,319.45	3,820,161.04	-17,955,920.91
经营活动产生的现金流量净额	4,192,816.09	-16,224,340.96	2,511,344.24	45,890,922.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

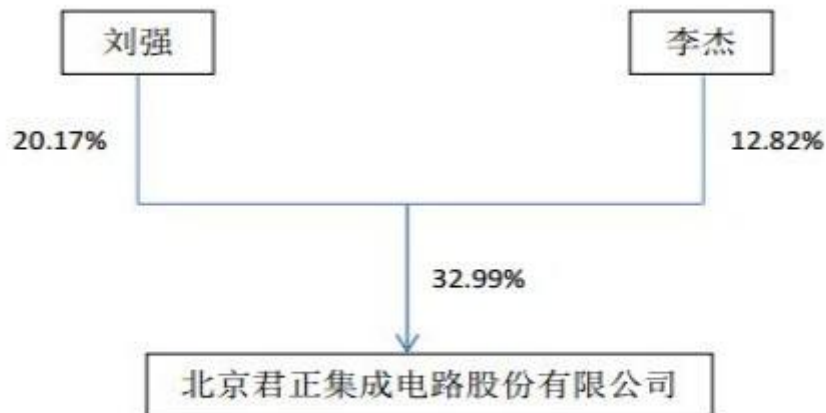
报告期末普通股股东总数	23,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘强	境内自然人	20.17%	40,475,544	30,356,658	质押	5,171,163	
李杰	境内自然人	12.82%	25,728,023	20,300,715	质押	20,874,333	
洗永辉	境内自然人	5.44%	10,908,659	8,181,494			
张紧	境内自然人	5.43%	10,894,285	8,170,714			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	3,461,080	0			
晏晓京	境内自然人	1.72%	3,451,961	2,588,970			
姜君	境内自然人	1.61%	3,233,496	2,425,122			
许志鹏	境内自然人	1.60%	3,218,575	2,434,106			
刘飞	境内自然人	1.55%	3,114,575	2,335,931			
刘文斌	境内自然人	0.92%	1,843,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司不断加强各应用领域的市场推广，加强芯片与方案的研发，公司产品在物联网和智能视频等领域的销售收入持续增长，尤其在物联网市场的销售收入增长幅度明显，使得公司总体营业收入和净利润较去年同期均显著增长。

报告期内，公司实现营业收入25,967.01万元，同比增长40.77%；实现净利润1,351.54万元，同比增长107.89%，其中归属于母公司股东的净利润1,351.54万元，同比增长107.89%。

具体来说，公司各方面的经营情况如下：

1、技术研发方面

报告期内，公司持续加大研发投入，不断加强技术研发和技术创新能力，根据市场的需求情况持续进行相关核心技术的开发，适时展开新兴领域新技术的跟踪与研究，并进行了相应的产品设计、研发。

公司对XBurst2 CPU的相关技术进行了持续的优化完善，XBurst2 CPU各项性能指标基本达到产品化要求。同时，公司展开了RISC-V CPU的研发工作。公司在CPU技术方面的积累将有助于公司快速研发RISC-V CPU内核，从而受益于这一新兴开放CPU架构所带来的产业机会。公司持续推进视频编解码技术、图像信号处理技术、声音信号处理技术、神经网络处理器技术及视频分析算法技术等技术开发，并逐渐将更多自主研发的核心技术应用于公司的芯片产品中。针对区块链方面技术和市场应用的不断发展，为增强公司在新领域的技术储备，公司进行了相关共识算法方面的技术跟踪与研发。芯片研发方面，公司对基于XBurst2 CPU的芯片产品进行了持续优化设计，该芯片产品将面向物联网类市场中的中高端应用，预计于2019年第二季度进行投片；基于深度优化的Smart H.264、Smart H.265技术，公司在智能视频领域进行了新产品的的设计开发与量产投片，新的芯片产品在成像、码流及功耗等性能方面有了进一步提高，能够很好地符合智能视频领域不断发展的产品需求；公司完成了面向视频领域深度学习的协处理器芯片的设计研发工作，于报告期内完成了芯片的投片，并进行了产品的小批量生产。公司将根据电子市场的发展变化，及时展开面向新领域的技术与产品的研究开发。

方案研发方面，结合市场发展趋势，公司在二维码、智能音频、智能家居家电、智能门锁和智能视频等重点领域进行了方案的更新与优化，支持重点客户进行个性化方案的开发，协助客户加快研发进度，推动客户产品更快地进入市场。报告期内，在物联网领域，公司的产品与方案在多类产品应用中得到客户认可，基于公司芯片的各类方案在性能、功耗、稳定性等方面均显示出明显的竞争优势。在智能视频领域，根据市场对视频品质整体水平要求的不断提升，公司不断优化各芯片平台的方案，推动客户产品的多元化发展；在这一领域中，电池类IPC产品在性能、功耗、智能化等方面要求较为严苛，研发难度相对较高，经过近两年的持续研发，公司电池类IPC产品方案完成了迭代升级，在功耗、稳定性、待机时间及核心功能等方面均显示了突出的优势，公司配合重点客户完成了定制化的电池类IPC产品设计，客户产品于报告期内推向市场。

2、市场开拓方面

报告期内，公司不断加强市场宣传与推广力度，深入挖掘各类市场的发展机会，结合公司产品优势与特点，在各个应用领域积极进行产品推广和客户拓展，及时跟进市场变动和客户产品的需求情况，根据市场需求情况对新产品进行规划和定义，公司的芯片产品在各市场领域的应用日趋丰富。

物联网市场的各类智能硬件产品日趋多样化、个性化，对芯片品质的需求也不断提高。为满足多样化的市场需求，公司及时针对新的应用和需求情况推出或优化相应的开发平台，以把握市场发展机遇。报告期内，国内二维码市场发展迅速，二维码设备在零售、票务、交通等各领域中的应用日渐增多，公司提早对二维码市场进行布局，及时抓住了该市场的发展机会，多家品牌客户均采用了公司的芯片产品，公司在该领域的销售收入同比显著增长。在音频市场，公司和方案商密切配合，积极寻求国内外的市场机会，公司无屏音箱和带屏音箱方案均完整落地，客户的各类智能音频产品陆续推向市场。在智能门锁市场，公司定制化的开发平台可支持指纹锁、人脸锁、指静脉锁及大屏指静脉锁等多种模式，公司立足于芯片低功耗、可扩展性强的优势，积极拓展品牌客户，协助客户进行多元化的产品设计，推动客户的产品尽快落地。在智能穿戴领域，公司协助华米科技推出了新一代智能运动手表，华米AMAZFIT系列运动手表得到消费者的高度认可。此外，公司在智能家居、智能家居面板等市场也进行了积极的推广。由于公司的芯片具有很好的通用性，在物联网市场产品种类不断丰富的趋势下，公司将不断寻求更多的市场机会。

在智能视频领域，专用安防市场和民用消费类IPC市场的竞争日趋激烈，在激烈的市场竞争中，公司充分发挥自身的产品优势和服务优势，努力拓展更多的品牌客户，根据客户需求及时规划新产品的研发和投片工作，客户新产品逐渐落地。在这一领域，电池类IPC产品的方案难度相对较高，相比其他安防类产品在国内属于较为新兴的应用，公司在电池类IPC市场进行了持续的方案研发与优化设计，报告期内，公司在这一领域获得市场突破，采用公司芯片的智能门铃产品推向市场。

除智能安防类产品外，公司在泛视频领域也积极进行产品推广，报告期内配合客户推出了儿童陪伴机器人、绘本机器人

等产品。

3、经营管理方面

公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，努力提高公司研发工作效率、提高公司整体管理水平。为进一步促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于2016年实施了股票期权激励计划，将部分高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员纳入本次激励范围。报告期内，公司股票期权激励计划第一个行权期于2018年4月12日结束；第二个行权期满足行权条件可以行权，行权期限为2018年4月13日至2019年4月12日，公司完成了本次股票期权的自主行权相关登记申报工作。报告期内，公司股票期权激励计划实际行权数量为204,622股。

4、投资并购方面

报告期内，公司以自有资金人民币1,000万元投资深圳吉迪思电子科技有限公司（以下简称“吉迪思”），取得其5.8824%的股权。吉迪思成立于2015年，主要从事智能设备显示主控芯片的设计、研发及相关电子产品的销售，其自主研发的AMOLED显示主控芯片已于2018年下半年开始销售。2019年3月，吉迪思其他股东对其进行增资，增资后公司持有吉迪思5.4267%的股权。

公司于2018年11月10日发布了重大资产重组预案，公司及/或全资子公司合肥君正拟通过发行股份及/或支付现金方式购买屹唐投资99.9993%财产份额、华创芯原100%股权、民和志威99.90%财产份额、Asia Memory100%股权、Worldwide Memory100%股权和厦门芯华100%财产份额，上述交易标的的主要资产为持有的北京矽成的股权。本次交易完成后，公司将间接持有北京矽成51.59%的股份和闪胜创芯53.29%的份额（闪胜创芯持有北京矽成3.785%的股份）。截至本报告出具之日，公司与各交易对手方尚未就本次重组方案的所有事项达成一致，公司将继续积极推进本次重组事项。

5、在建工程方面

报告期内，合肥君正一期研发楼的建设工作基本完成，处于室外配套工程的安装调试阶段及接入市政管网准备阶段，待市政管网接入工作完成后，合肥君正将启动后续相关工程收尾及报审验收工作；公司对合肥君正二期研发楼进行了方案的前期沟通设计，预计于2019年开始各项建设工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
微处理器芯片	144,824,560.13	69,111,219.77	47.72%	60.44%	52.54%	2.71%
智能视频芯片	99,485,451.40	21,081,382.61	21.19%	22.48%	19.68%	1.84%
技术服务	1,152,219.27	1,152,219.27	100.00%	9.95%	0.00%	0.00%
其他	3,544,697.76	2,216,518.20	62.53%	116.47%	325.24%	-18.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定对2017年度财务报表的主要影响如下：

项目	2017年12月31日/2017年	2017年12月31日/2017年	2017年12月31日/2017年	2017年12月31日/2017年
	度	度	度	度
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司（经重述）
应收票据及应收账款		13,241,437.38		3,537,214.04
应收账款	13,241,437.38		3,537,214.04	
应付票据及应付账款		3,400,967.97		1,781,024.83
应付账款	3,400,967.97		1,781,024.83	
管理费用	83,795,173.16	27,055,042.31	55,357,907.73	20,357,960.91
研发费用		56,740,130.85		34,999,946.82
财务费用	-247,405.86	-247,405.86	-490,454.40	-490,454.40
利息收入		728,123.12		634,603.85

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强 _____

二〇一九年四月十八日